

附件一

电子元器件自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2024《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共 21 项，其中自主可控 A 级 0 项、B 级 0 项、C 级 0 项、C*级 21 项、D 级 0 项、E 级 0 项；伪国产化 0 项、包装国产化 0 项、空心国产化 0 项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表一；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表二。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。



附表一

电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	生产厂商 ^c	自主可控等级 ^d	是否“伪国产化” ^e		是否“包装国产化” ^e		是否“空心国产化” ^e		备注 ^e
					是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	电压基准	JTLX5020XK	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
2	电压基准	JTLX5025XK	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
3	电压基准	JTLX5030XK	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
4	电压基准	JTLX5033XK	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
5	电压基准	JTLX5040XK	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
6	电压基准	JTLX5045XK	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
7	电压基准	JTLX5050XK	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
8	电压基准	JTLX5020XK(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
9	电压基准	JTLX5025XK(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
10	电压基准	JTLX5030XK(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
11	电压基准	JTLX5033XK(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
12	电压基准	JTLX5040XK(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	

填报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

填表人（签字）：

电话：13699386074 填报日期：20250620

13	电压基准	JTLX5045XK(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
14	电压基准	JTLX5050XK(W)	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
15	电压基准	TLX5020XK	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
16	电压基准	TLX5025XK	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
17	电压基准	TLX5030XK	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
18	电压基准	TLX5033XK	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
19	电压基准	TLX5040XK	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
20	电压基准	TLX5045XK	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	
21	电压基准	TLX5050XK	无锡泰连芯科技有限公司	C*	否	无	否	无	否	无	

填表说明:

- ^a. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
- ^b. 应填写元器件完整型号规格；
- ^c. 应填写元器件生产厂商中文全称，勿填写代理商；
- ^d. 按照 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行，分为 A、B、C、C*、D、E 六个等级，针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行；
- ^e. “伪、空、包”应按照 ZKB3101-002-2022 标准执行。若为“是”时，则需要在“情况说明”写明判别因素；若为“否”时，则填“无”；
- ^f. 若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。

填报单位(盖章): 法定代表人(签章): 侯仕颖 填表人(签字): 侯仕颖 电话: 13699386074 填报日期: 20250620

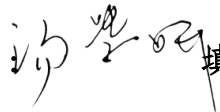


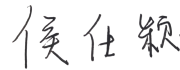
附表二

电子元器件基本信息表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	使用 IP 核情况 ^c				原材料和零部件 ^d				流片工艺 ^g		备注
			名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否“核心”/“关键” ^e	来源单位 ^f	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	电压基准	JTLX5020XK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
2	电压基准	JTLX5025XK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
3	电压基准	JTLX5030XK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
4	电压基准	JTLX5033XK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
5	电压基准	JTLX5040XK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
6	电压基准	JTLX5045XK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
7	电压基准	JTLX5050XK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

填报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

填表人（签字）：

电话：13699386074

填报日期：20250620

8	电压基准	JTLX5020XK(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
9	电压基准	JTLX5025XK(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
10	电压基准	JTLX5030XK(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
11	电压基准	JTLX5033XK(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
12	电压基准	JTLX5040XK(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
13	电压基准	JTLX5045XK(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
14	电压基准	JTLX5050XK(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
15	电压基准	TLX5020XK	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
16	电压基准	TLX5025XK	IP核1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

填表人(签字):

电话:13699386074

填报日期:20250620

17	电压基准	TLX5030XK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
18	电压基准	TLX5033XK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
19	电压基准	TLX5040XK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
20	电压基准	TLX5045XK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			
21	电压基准	TLX5050XK	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	东部高科	境外	0.18um CMOS	境外	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天	境内			

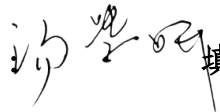
填表说明：

- ^a. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
- ^b. 应填写元器件完整型号规格；
- ^c. 仅适用于半导体集成电路，应填写 IP 核类型，包括“软核”“固核”“硬核”；
- ^d. 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写，至少包含 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 中内部零部件或原材料，同时也应包含外壳、引出端、键合丝等，不包含灌封料等生产过程材料；
- ^e. 应根据 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 填写“核心”或“关键”，非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填；
- ^f. 应根据实际设计单位或生产商情况填写，不能按代理商填写；对来源不明的，应填写“来源不明”，具体判定时视为“境外”；
- ^g. 仅适用于半导体集成电路，应填写流片工艺名称，如 45nmBCD 工艺等，必要时在备注中填写流片厂商信息。

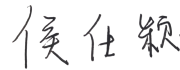
填表单位（盖章）：



法定代表人（签章）：



填表人（签字）：



电话：

13699386074

填报日期：

20250620